

Mars系列

显微成像晶圆缺陷检测设备

Imaging Based Wafer Defect Inspection System



应用范围 Application Scope

晶圆类型

衬底片和外延片的表面及晶格缺陷检测

晶圆尺寸

兼容4, 6, 8, 12英寸及其它非标尺寸

设备特点及优势 Product Introduction

成像方式

面阵积分, PL暗信号检测能力强, 实时自动对焦

成像通道

明场(含微分干涉相差)、近紫外/近红外光致发光、暗场同步检测

检测算法

深度学习多通道同步识别算法, 支持三百万以上缺陷实时分析, 可全面检出各类缺陷

性能优异

高分辨率、高灵敏度(83 nm)、高检测通量, 全面覆盖各类化合物晶圆缺陷

中电科风华信息装备股份有限公司

网 址: <http://www.zdkfh-ie.com/>

电 话: 18636141900

邮 箱: wangze@zdkfh-ie.com

太原基地: 山西转型综合改革示范区潇河产业园宏业东路11号

上海基地: 上海市闵行区浦江镇江月路999号21号楼



公众号



视频号

软件算法 Software Algorithm

- ◆ 自动配方训练和多通道同位对比
- ◆ 支持缺陷列表筛选、排序及快速查图
- ◆ 支持检测结果关联，云服务数据追溯与共享
- ◆ 支持晶圆划分生成良率分布图
- ◆ 可做再分析及缺陷客制化分规
- ◆ 支持SECS/GEM通信协议，可与MES系统交互

性能参数 Performance Parameters

技术参数	性能指标
System Size 设备尺寸	1.535 m (L) x 1.585 m (W) x 2.35 m (H)
Inspection Channels 检测通道	明场、暗场、PL1 & PL2, 同步检测
Sensitivity 灵敏度	83 nm
Repeatability 重复性	≥95%

检测图例 Inspected Defects

